STANDARDLAGENAUFBAU HDI

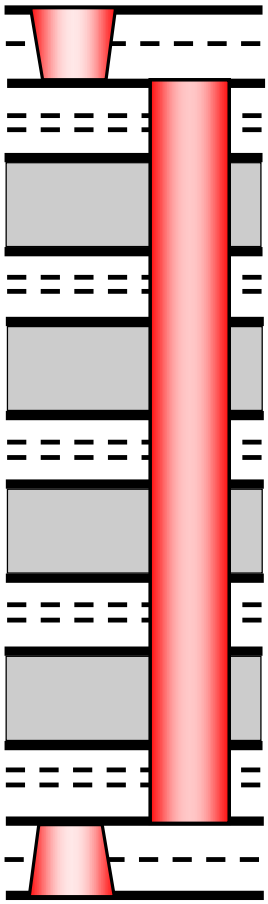
HDI12_1+10b+1_1,50_35

12 - Lagen

Kerne: 0,10 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 10B + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1		Folie	9 µm		**30**	
					2 x 1080	**133**	
3	2			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
4	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
5	4			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
6	5			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
7	6			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
8	7			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
9	8			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
10	9			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**133**	
11	RSK1			9 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
12	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1506

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,12	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,15	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,17	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
29.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	10+